2026-2031年全球及中国半导体封装设备（封测）行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——
第1章：半导体封装设备综述/产业画像/研究说明
1.1 半导体封装设备产业综述
1.1.1 半导体封装设备的界定
1.1.2 半导体封装设备的分类
1.1.3 半导体封装设备所处行业
1.1.4 半导体封装设备市场监管
1.1.5 半导体封装设备标准规范
1.2 半导体封装设备产业画像
1.2.1 半导体封装设备产业链结构示意图
1.2.2 半导体封装设备产业链生态全景图
1.2.3 半导体封装设备产业链区域热力图
1.3 半导体封装设备研究说明
1.3.1 本报告研究范围界定
1.3.2 本报告权威数据来源
1.3.3 本报告研究统计方法
——现状篇——
第2章：全球半导体封装设备行业发展现状分析
2.1 全球半导体封装设备行业发展历程
2.2 全球半导体封装设备市场规模体量
2.3 全球半导体封装设备市场供需现状
2.3.1 全球半导体封装设备市场供给/生产
2.3.2 全球半导体封装设备典型企业/布局
2.3.3 全球半导体封装设备市场需求/销售
2.3.4 全球半导体封装设备供需缺口走势
2.4 全球半导体封装设备细分市场概况
2.4.1 全球半导体封装设备细分市场发展概况
2.4.2 全球半导体封装设备细分领域布局企业
2.4.3 全球半导体封装细分领域设备需求概况
1、全球半导体封装市场发展现状
2、全球半导体封装细分市场结构
3、全球半导体传统封装市场概况
4、全球半导体先进封装市场概况
2.5 全球半导体封装设备市场竞争态势
2.5.1 全球半导体封装设备市场竞争格局
2.5.2 全球半导体封装设备市场集中度
2.5.3 全球半导体封装设备并购交易态势
2.5.4 全球半导体封装设备投融资动态
2.6 全球半导体封装设备区域发展格局
2.6.1 全球半导体封装设备区域发展格局
2.6.2 全球半导体封装设备区域贸易流向
2.6.3 国外半导体封装设备发展经验借鉴
2.7 全球半导体封装设备重点区域分析
2.7.1 重点区域半导体封装设备市场概况——日本
2.7.2 重点区域半导体封装设备市场概况——德国
2.7.2 重点区域半导体封装设备市场概况——美国
2.8 全球半导体封装设备市场前景预测
2.9 全球半导体封装设备发展趋势洞悉
第3章：中国半导体封装设备行业发展现状分析

3.1 中国半导体封装设备行业发展历程
3.2 中国半导体封装设备市场规模体量
3.3 中国半导体封装设备研发生产模式
3.4 中国半导体封装设备市场主体类型
3.4.1 中国半导体封装设备市场参与者类型
3.4.2 中国半导体封装设备企业数量名单
3.4.3 中国半导体封装设备企业入场进程
3.4.4 中国半导体封装设备企业入场方式
3.5 中国半导体封装设备企业布局/产品
3.5.1 中国半导体封装设备主要企业布局
3.5.2 中国半导体封装设备上市产品数量
3.6 中国半导体封装设备供给现状/生产
3.6.1 中国半导体封装设备生产能力/产能
3.6.2 中国半导体封装设备生产情况/产量
3.7 中国半导体封装设备对外贸易/顺差
3.7.1 半导体封装设备适用海关HS编码
3.7.2 中国半导体封装设备对外贸易概况
3.7.3 中国半导体封装设备进口贸易概况
3.7.4 中国半导体封装设备出口贸易概况
3.8 中国半导体封装设备需求现状/销售
3.8.1 中国半导体封装设备市场流通/渠道
3.8.2 中国半导体封装设备渗透率/普及率
3.8.3 中国半导体封装设备市场需求量变化
3.8.4 中国半导体封装设备企业销售量对比
3.9 中国半导体封装设备供求关系/价格
3.9.1 中国半导体封装设备库存及产销率
3.9.2 中国半导体封装设备市场供求关系
3.9.3 中国半导体封装设备市场价格水平
3.9.4 中国半导体封装设备企业的毛利率
3.10 中国半导体封装设备招标投标/采购
3.10.1 半导体封装设备招标投标/模式政策
3.10.2 半导体封装设备招标投标/采购汇总
3.10.3 半导体封装设备招标投标/采购规模
3.10.4 半导体封装设备招标投标/采购分析
3.11 中国半导体封装设备行业发展痛点/挑战
第4章：中国半导体封装设备市场竞争及投融资
4.1 中国半导体封装设备行业竞争对手分析（同业竞争者）
4.1.1 中国半导体封装设备现有直接竞争者的竞争程度
4.1.2 中国半导体封装设备潜在/跨界竞争者的进入威胁
4.1.3 中国半导体封装设备替代品竞争者份额争夺威胁
4.2 中国半导体封装设备行业竞争态势矩阵（CPM）
4.2.1 中国半导体封装设备企业关键成功因素KSF
4.2.2 中国半导体封装设备行业竞争者的竞争势头
4.2.3 中国半导体封装设备行业竞争者的战略集群
4.3 中国半导体封装设备市场竞争结构分析
4.3.1 中国半导体封装设备行业所处生命周期阶段
4.3.2 中国半导体封装设备行业市场集中度（CRn）
4.4 中国半导体封装设备市场竞争格局分析
4.4.1 中国半导体封装设备市场竞争梯队
4.4.2 中国半导体封装设备市场竞争格局
4.4.3 半导体封装设备外企在华市场竞争
4.4.4 半导体封装设备外企在华布局现状
4.4.5 半导体封装设备行业国产替代进程
4.5 中国半导体封装设备出海布局及竞争力
4.5.1 中国半导体封装设备企业出海布局现状
4.5.2 中国半导体封装设备企业海外市场竞争力
4.6 中国半导体封装设备竞争者的投资并购
4.6.1 中国半导体封装设备企业投资布局
4.6.2 中国半导体封装设备企业兼并重组

4.7 中国半导体封装设备竞争者的融资现状
4.7.1 中国半导体封装设备行业资金来源
4.7.2 中国半导体封装设备企业IPO动态
4.7.3 中国半导体封装设备企业融资事件
4.7.4 中国半导体封装设备企业融资规模
4.7.5 中国半导体封装设备热门融资赛道
第5章：中国半导体封装设备技术进展及供应链
5.1 半导体封装设备技术/进入壁垒
5.1.1 半导体封装设备核心竞争力/护城河——研发+技术+品控
5.1.2 半导体封装设备技术壁垒/进入壁垒
5.2 半导体封装设备人才/基础研发
5.2.1 半导体封装设备企业研发人员数量/比重
5.2.2 半导体封装设备企业研发投入力度/强度
5.2.3 半导体封装设备企业研发项目/投入方向
5.2.4 半导体封装设备知识产权统计/专利技术
5.2.5 半导体封装设备科研创新动态/论文发表
5.2.6 半导体封装设备技术研发方向/未来重点
5.3 半导体封装设备工艺/关键技术
5.3.1 半导体封装设备生产工艺流程
5.3.2 半导体封装设备技术路线全景
5.3.3 半导体封装设备关键核心技术
5.4 半导体封装设备设计/成本结构
5.4.1 半导体封装设备基本结构组成
5.4.2 半导体封装设备生产成本结构
5.4.3 半导体封装设备产业价值链条
5.4.4 半导体封装设备价格传导机制
5.5 配套供应链：半导体封装材料
5.5.1 半导体封装材料概述
5.5.2 半导体封装材料市场概况
5.5.3 半导体封装材料——封装基板
1、封装基板概述
2、封装基板市场概况
3、封装基板供应商格局
5.5.4 半导体封装材料——引线框架
1、引线框架概述
2、引线框架市场概况
3、引线框架供应商格局
5.5.5 半导体封装材料——键合丝
1、键合丝概述
2、键合丝市场概况
3、键合丝供应商格局
5.6 配套供应链：半导体封装设备零部件
5.6.1 半导体封装设备零部件概述
5.6.2 半导体封装设备零部件市场概况
5.6.3 半导体封装设备零部件供应商格局
5.6.4 半导体封装设备零部件——贴片头（贴片机）
1、贴片头（贴片机）概述
2、贴片头（贴片机）市场概况
3、贴片头（贴片机）供应商格局
5.6.5 半导体封装设备零部件——空气主轴（划片机）
1、空气主轴（划片机）概述
2、空气主轴（划片机）市场概况
3、空气主轴（划片机）供应商格局
5.6.6 半导体封装设备零部件——键合头（键合机）
1、键合头（键合机）概述
2、键合头（键合机）市场概况
3、键合头（键合机）供应商格局
5.7 半导体封装设备的供应链管理挑战
第6章：中国半导体封装设备细分市场发展分析

6.1 半导体封装设备细分产品综合对比
6.2 半导体封装设备行业细分市场发展概况
6.2.1 半导体封装设备细分市场发展概况
6.2.2 半导体封装设备细分市场结构变化
6.3 半导体封装设备：贴片机（固晶机）
6.3.1 贴片机（固晶机）概述
6.3.2 贴片机（固晶机）市场概况
6.3.3 贴片机（固晶机）竞争格局
6.3.4 贴片机（固晶机）发展趋势
6.4 半导体封装设备：划片机（切片机）
6.4.1 划片机（切片机）概述
6.4.2 划片机（切片机）市场概况
6.4.3 划片机（切片机）竞争格局
6.4.4 划片机（切片机）发展趋势
6.5 半导体封装设备：键合机
6.5.1 键合机概述
6.5.2 键合机市场概况
6.5.3 键合机竞争格局
6.5.4 键合机发展趋势
6.6 半导体封装设备：塑封机
6.6.1 塑封机概述
6.6.2 塑封机市场概况
6.6.3 塑封机竞争格局
6.6.4 塑封机发展趋势
6.7 半导体封装设备：电镀机/电镀设备
6.7.1 电镀机概述
6.7.2 电镀机市场概况
6.7.3 电镀机竞争格局
6.7.4 电镀机发展趋势
6.8 半导体封装设备：封装光刻机
6.9 半导体封装设备细分市场战略地位分析
第7章：中国半导体封装设备细分应用市场分析
7.1 半导体封装设备客户类型及下游需求特征
7.1.1 中国半导体封装设备下游客户类型
7.1.2 中国半导体封装设备市场需求特征
7.2 半导体封装设备应用场景及下游行业分布
7.2.1 半导体封装设备潜在应用场景
7.2.2 半导体封装设备应用领域分布
7.3 半导体封装设备应用场景：传统封装
7.3.1 传统封装流程及所需设备类型
7.3.2 传统封装发展现状及设备需求
7.3.3 传统封装发展趋势及设备需求
7.4 半导体封装设备应用场景：倒装封装
7.4.1 倒装封装流程及所需设备类型
7.4.2 倒装封装发展现状及设备需求
7.4.3 倒装封装发展趋势及设备需求
7.5 半导体封装设备应用场景：WLP（晶圆级封装）
7.5.1 WLP（晶圆级封装）流程及所需设备类型
7.5.2 WLP（晶圆级封装）发展现状及设备需求
7.5.3 WLP（晶圆级封装）发展趋势及设备需求
7.6 半导体封装设备应用场景：2.5D/3D封装
7.6.1 2.5D/3D封装流程及所需设备类型
7.6.2 2.5D/3D封装发展现状及设备需求
7.6.3 2.5D/3D封装发展趋势及设备需求
7.7 半导体封装设备细分应用战略地位分析
第8章：全球及中国半导体封装设备企业案例解析
8.1 全球及中国半导体封装设备企业梳理对比
8.2 全球半导体封装设备企业案例分析（不分先后，可指定）
8.2.1 DISCO（迪斯科）

1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业半导体封装设备业务布局
4、企业半导体封装设备在华布局
8.2.2 Tokyo Seimitsu（东京精密）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业半导体封装设备业务布局
4、企业半导体封装设备在华布局
8.2.3 Koyo Seiko（光洋精工）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业半导体封装设备业务布局
4、企业半导体封装设备在华布局
8.2.4 Besi（贝思半导体）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业半导体封装设备业务布局
4、企业半导体封装设备在华布局
8.2.5 ASMPT（ASM太平洋）
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业半导体封装设备业务布局
4、企业半导体封装设备在华布局
8.3 中国半导体封装设备企业案例分析（不分先后，可指定）
8.3.1 深圳新益昌科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.2 光力科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.3 华海清科股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局

6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.4 文一三佳科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.5 安徽耐科装备科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.6 快克智能装备股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.7 拓荆科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.8 无锡奥特维科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术

5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.9 昆山东威科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
8.3.10 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况
（2）产品结构
（3）销售区域
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业半导体封装设备布局
6、企业半导体封装设备客户
7、企业发展战略&优劣势
——展望篇——
第9章：中国半导体封装设备行业政策环境/PEST/SWOT
9.1 国家半导体封装设备行业政策汇总解读
9.1.1 中国半导体封装设备行业政策汇总
9.1.2 中国半导体封装设备行业发展规划
9.1.3 中国半导体封装设备重点政策解读
9.2 地方半导体封装设备行业政策规划汇总
9.2.1 各地半导体封装设备政策规划汇总
9.2.2 各地半导体封装设备的政策热力图
9.2.3 各地半导体封装设备发展目标解读
9.3 中国半导体封装设备行业经济社会环境
9.3.1 中国半导体封装设备经济环境分析
9.3.2 中国半导体封装设备社会环境分析
9.4 中国半导体封装设备行业PEST环境总结
9.4.1 中国半导体封装设备政策环境总结（P）
9.4.2 中国半导体封装设备经济环境总结（E）
9.4.3 中国半导体封装设备社会环境总结（S）
9.4.4 中国半导体封装设备技术环境总结（T）
9.5 中国半导体封装设备行业SWOT分析图
第10章：中国半导体封装设备行业发展潜力及前景展望
10.1 中国半导体封装设备行业发展潜力评估
10.2 中国半导体封装设备行业发展前景预测
10.3 中国半导体封装设备行业发展趋势洞悉
10.3.1 中国半导体封装设备行业整体发展趋势
10.3.2 中国半导体封装设备行业监管规范趋势
10.3.3 中国半导体封装设备行业技术创新趋势
10.3.4 中国半导体封装设备行业细分市场趋势
10.3.5 中国半导体封装设备行业市场竞争趋势
10.3.6 中国半导体封装设备行业市场供需趋势
第11章：中国半导体封装设备行业发展机遇及策略建议
11.1 中国半导体封装设备行业投资机遇分析——全产业链配套
11.1.1 不足：半导体封装设备产业链薄弱点投资机会

11.1.2 欠缺：半导体封装设备产业链空白点投资机会
11.2 中国半导体封装设备行业投资机遇分析——细分市场布局
11.2.1 中游：半导体封装设备细分产品生产布局机会
11.2.2 下游：半导体封装设备细分应用领域/场景机会
11.3 中国半导体封装设备行业投资机遇分析——优势区域布局
11.3.1 国内：半导体封装设备行业区域市场投资机会
11.3.2 海外：半导体封装设备海外投资布局/出海机会
11.4 中国半导体封装设备行业未来关键增长点
11.5 中国半导体封装设备行业投资价值评估
11.6 中国半导体封装设备行业投资策略建议
11.6.1 中国半导体封装设备行业投资风险预警
11.6.1 中国半导体封装设备行业投资策略建议
11.7 中国半导体封装设备行业可持续发展建议

图表目录

图表1：半导体封装设备的定义
图表2：半导体封装设备的特征
图表3：半导体封装设备的分类
图表4：半导体封装设备所处行业
图表5：半导体封装设备监管体系
图表6：半导体封装设备监管机构
图表7：半导体封装设备标准体系
图表8：半导体封装设备标准汇总
图表9：半导体封装设备产业链结构示意图
图表10：半导体封装设备产业链生态全景图
图表11：半导体封装设备产业链区域热力图
图表12：本报告研究范围界定
图表13：本报告权威数据来源
图表14：本报告研究统计方法
图表15：全球半导体封装设备行业发展历程
图表16：全球半导体封装设备市场规模体量
图表17：2019-2025年全球及中国半导体封装设备市场规模及比重分析（单位：亿美元，%）
图表18：全球半导体封装设备市场供给/生产
图表19：全球半导体封装设备典型企业/布局
图表20：全球半导体封装设备市场需求/销售
图表21：全球半导体封装设备供需缺口走势
图表22：全球半导体封装设备细分市场发展概况
图表23：全球半导体封装设备细分产品占比（单位：%）
图表24：全球半导体封装设备细分领域布局企业
图表25：全球半导体封装市场发展现状
图表26：全球半导体封装细分市场结构
图表27：全球半导体传统封装市场概况
图表28：全球半导体先进封装市场概况
图表29：全球半导体封装设备市场竞争格局
图表30：全球半导体封装设备市场集中度
图表31：全球半导体封装设备并购交易态势
图表32：全球半导体封装设备投融资动态
图表33：全球半导体封装设备区域发展格局
图表34：全球半导体封装设备区域贸易流向
图表35：国外半导体封装设备发展经验借鉴
图表36：日本半导体封装设备行业发展概况
图表37：德国半导体封装设备行业发展概况
图表38：美国半导体封装设备行业发展概况
图表39：全球半导体封装设备市场前景预测（2026-2031年）
图表40：全球半导体封装设备发展趋势洞悉

图表41：中国半导体封装设备行业发展历程
图表42：中国半导体封装设备市场规模体量
图表43：中国半导体封装设备研发生产模式
图表44：中国半导体封装设备市场参与者类型
图表45：中国半导体封装设备企业数量名单
图表46：中国半导体封装设备企业入场进程
图表47：中国半导体封装设备企业入场方式
图表48：中国半导体封装设备主要企业布局
图表49：中国半导体封装设备上市产品数量
图表50：中国半导体封装设备生产能力/产能（单位：万吨/年）
图表51：中国半导体封装设备生产情况/产量
图表52：中国半导体封装设备适用海关编码
图表53：中国半导体封装设备对外贸易概况
图表54：中国半导体封装设备进口贸易概况
图表55：中国半导体封装设备出口贸易概况
图表56：中国半导体封装设备市场流通渠道
图表57：中国半导体封装设备企业销售渠道
图表58：中国半导体封装设备渗透率/普及率
图表59：中国半导体封装设备市场需求量变化
图表60：中国半导体封装设备企业销售量对比
图表61：中国半导体封装设备库存及产销率
图表62：中国半导体封装设备市场供求关系
图表63：中国半导体封装设备供需平衡表
图表64：中国半导体封装设备市场价格走势
图表65：中国半导体封装设备企业的毛利率
图表66：中国半导体封装设备招标投标/模式政策
图表67：中国半导体封装设备招标投标/采购汇总
图表68：中国半导体封装设备招标投标/采购规模
图表69：中国半导体封装设备集中招标采购分析
图表70：中国半导体封装设备行业发展痛点/挑战
图表71：中国半导体封装设备现有直接竞争者的竞争程度
图表72：中国半导体封装设备潜在竞争者的进入威胁
图表73：中国半导体封装设备关键成功因素KSF
图表74：中国半导体封装设备行业竞争者的竞争势头
图表75：中国半导体封装设备行业竞争者的战略集群
图表76：中国半导体封装设备行业所处生命周期阶段
图表77：中国半导体封装设备行业市场集中度（CRn）
图表78：中国半导体封装设备市场竞争梯队
图表79：中国半导体封装设备市场竞争格局
图表80：半导体封装设备外企在华市场竞争
图表81：半导体封装设备外企在华布局动态
图表82：中国半导体封装设备企业海外销售占比
图表83：中国半导体封装设备企业投资布局
图表84：中国半导体封装设备企业兼并重组
图表85：中国半导体封装设备行业资金来源
图表86：中国半导体封装设备企业IPO动态
图表87：中国半导体封装设备企业融资事件
图表88：中国半导体封装设备企业融资规模
图表89：中国半导体封装设备热门融资赛道
图表90：半导体封装设备核心竞争力/护城河
图表91：半导体封装设备技术壁垒/进入壁垒
图表92：半导体封装设备企业研发人员数量
图表93：半导体封装设备企业研发投入力度/强度
图表94：半导体封装设备企业研发项目/投入方向
图表95：半导体封装设备知识产权统计/专利技术
图表96：半导体封装设备科研创新动态/论文发表
图表97：半导体封装设备技术研发方向/未来重点
图表98：半导体封装设备生产工艺流程图
图表99：半导体封装设备技术路线全景图

图表100：半导体封装设备关键核心技术
图表101：半导体封装设备基本结构组成
图表102：半导体封装设备生产成本结构
图表103：半导体封装设备产业价值链条
图表104：半导体封装设备价格传导机制
图表105：半导体封装材料概述
图表106：半导体封装材料价格波动
图表107：半导体封装设备零部件概述
图表108：半导体封装设备零部件市场概况
图表109：半导体封装设备的供应链管理挑战
图表110：半导体封装设备各类产品综合对比
图表111：半导体封装设备细分市场发展概况
图表112：半导体封装设备细分市场结构变化
图表113：贴片机（固晶机）概述
图表114：贴片机（固晶机）市场概况
图表115：贴片机（固晶机）竞争格局
图表116：贴片机（固晶机）发展趋势
图表117：划片机（切片机）概述
图表118：划片机（切片机）市场概况
图表119：划片机（切片机）竞争格局
图表120：划片机（切片机）发展趋势
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！